

2024半导体展会|2024中国(电子芯片博览会)半导体展会|半导体光电器件展览会

产品名称	2024半导体展会 2024中国(电子芯片博览会)半导体展会 半导体光电器件展览会
公司名称	中国(耀瀚)展会信息
价格	.00/件
规格参数	半导体展:国际展
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

半导体展览会 | 2024中国(深圳)半导体展会 | 深圳半导体产业展

时间: 2024年6月26-28日

地点: 深圳国际会展中心(新馆)

组织机构: 中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、广州市半导体行业协会、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

组展单位: [深圳市中新材会展有限公司](#)

SEMI-e以“芯机会?智未来”为主题,汇聚众多和学者,进一步加强全球集成电路产业的交流与合作,围绕中国国际集成电路产业与应用,立足深圳、辐射全国,旨在集中展示集成电路产业发展成果,加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA设计工具等产业链关键环节攻关突破,加强珠三角产业链协作,逐步形成综合性集成电路产业集群,打造华南集成电路产业交流与贸易平台,推动华南集成电路产业集聚区更快更好发展。本届展会顺应产业发展趋势,服务于十几个新兴行业应用。

中国市场的半导体销售占了全球的1/3,是份额大的,相当于美国、欧盟及日本的总和,不过这主要是因为中国是全球制造的中心,尤其是电脑、手机产量,消耗了多的芯片。随着人工智能的快速发展,以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下,半导体的需求持续增加。预计2021年中国半导体市场需求规模将进一步扩大,市场需求规模有望达到19850亿元。为更推动半导体业界交流互动,tisheng半导体行业国际化水平,“2024中国(深圳)国际半导体展览会”将于2024年6月26-28日在深圳国际会展中心隆重召开。分为展览会、高峰论坛和学术会议三大板块,是半导体行业的年度盛会,也是半导体行业和相关产业交流合作的综合性展示平台。

展出范围：

- 1、半导体设计、封测、制造产厂商。
- 2、原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；
- 3、生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD、光刻机、蚀刻机、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片、沉积系统、清洗设备；
- 4、封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机、焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备
- 5、测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、liuliang控制、石英石墨、碳化硅等；
- 6、IC 产品与应用技术、IC 测试方法与测试仪器、IC 设计与设计工具、IC 制造与封装；
- 7、电子气体：集成电路、平面显示器件及其它电子产品生产的特种气体企业；
- 8、半导体分立器件产品、半导体光电器件、集成电路终端产品；

本届展会是顺应产业发展的趋势，服务于十几个新兴行业应用，将邀请AI、自动驾驶、物联网、5G通信、智能终端、智能传感等数十个新兴应用领域芯片半导体企业展示新的解决方式，推动半导体产业与新兴应用市场有效结合，邀请终端大企业用户参观交流，引领设计、制造、封测、材料和设备厂商开展合作与对话，打造热门细分市场 and 新兴应用终端客户以及半导体产业链紧密合作交流的平台，了解展会详情介绍及新展位图烦请垂询